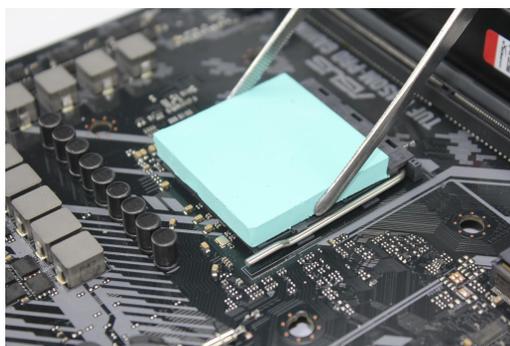


导热硅胶垫片

TP500-H40-9是一款高导热性能的材料，双面自粘，与电子组件装配使用时，低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性，在-40°C~150°C可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数5.0W/(m·K)
- 超低压缩
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 韧性好易操作

典型应用

- 电压调节模块(VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高速大存储驱动
- 网络通讯设备
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	绿色	目视
厚度(mm)	0.75~6.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
硬度(Shore 00)	40	ASTM D2240
重量损失(%)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25%,125°C,48h 初始直径Φ30mm
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	7.1	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	5.0	ISO 22007-2

注: 1.0mm以下产品操作性需要得到客户认可。